



股票代號

6515

穎歲科技股份有限公司

法人說明會

● ● ● ● ● 2024.11.28

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。

本公司未來實際所可能產生的營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測性資訊有所差異。其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、各種政策法令與金融經濟現況之改變，以及其他本公司無法掌控之風險等因素。

本簡報中所提供之資訊，係反應本公司截至目前為止對於未來的看法，並未明示或暗示性地表達或保證其具有正確性、完整性或可靠性。對於這些看法，未來若有變更或調整時，本公司並不負有更新或修正之責任。



公司簡介

■ 成立日期

西元 2001 年 4 月 10 日

■ 服務項目

半導體測試介面研發設計及製造銷售

■ 董事長兼總經理

王嘉煌

■ 實收資本額

NTD 350,153,320

■ 員工人數

1001人

■ 登記地址

高雄市楠梓區創意南路68號



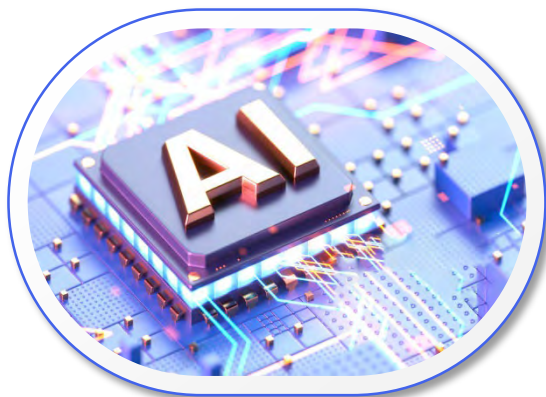
高雄總公司



新竹分公司

經營理念

始終站在客戶的角度思考所有半導體測試需求，並透過客戶參與、技術創新、製造管理及供應鏈整合，持續堅持品質，服務全球，致力於為客戶、員工、供應商及股東創造最大的福利並善盡社會責任。



持續創新

透過技術創新
為客戶打造最佳
測試介面解決方案



堅持品質

提供整體解決方案
並於全球準時交付
超越客戶的品質要求



全球服務

致力成為全球領先的
專業測試服務供應商
在 IC 測試各階段提供最佳服務

簡報大綱



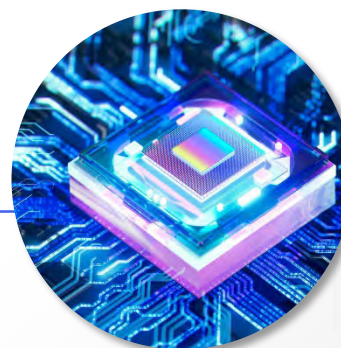
全球布局



產業趨勢



經營績效

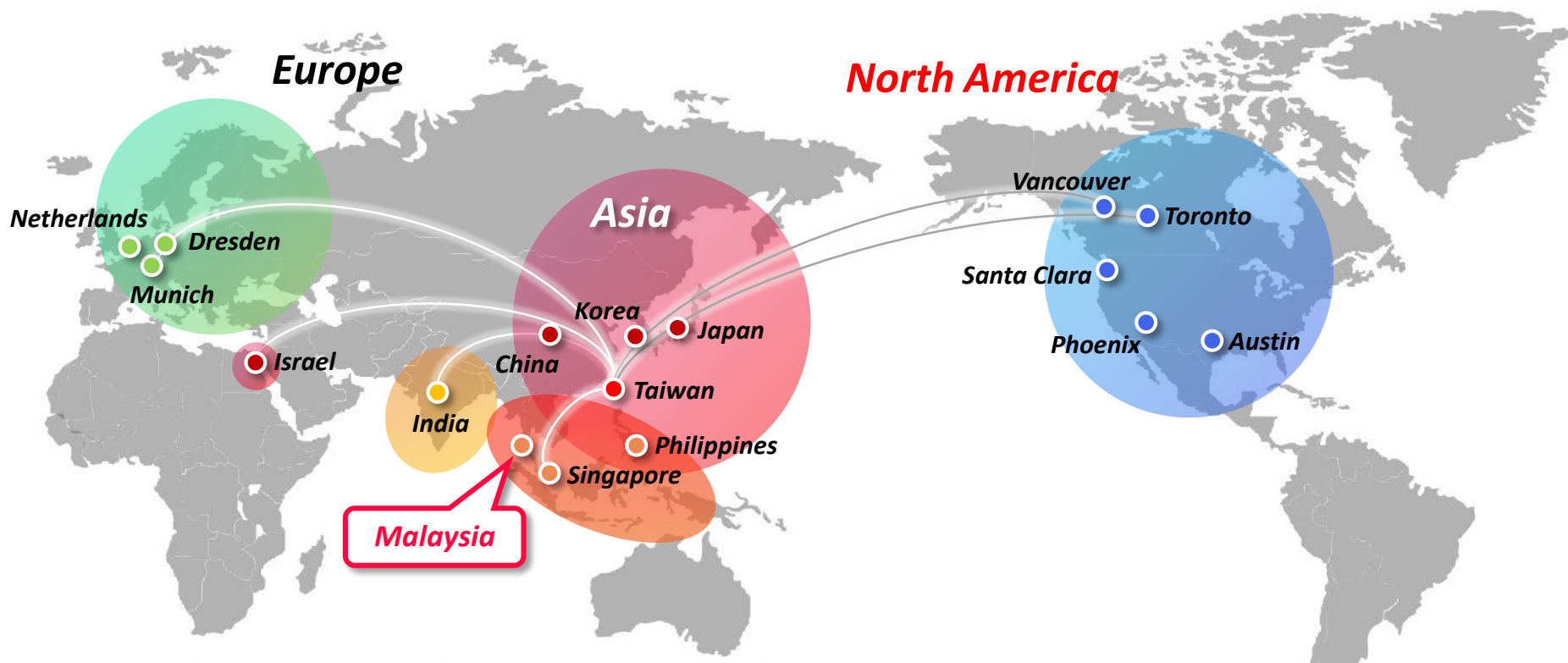


研發創新

01

全球布局

技術創新 服務全球

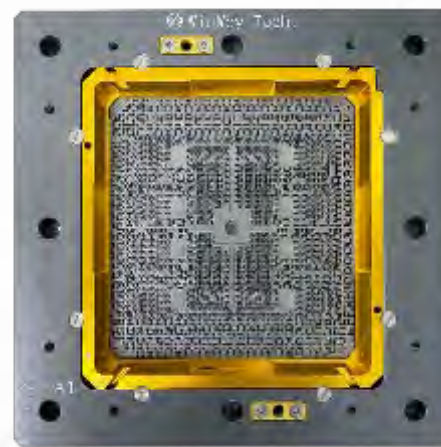


半導體測試介面領導廠商

3

2023

**Test Socket
Ranking**

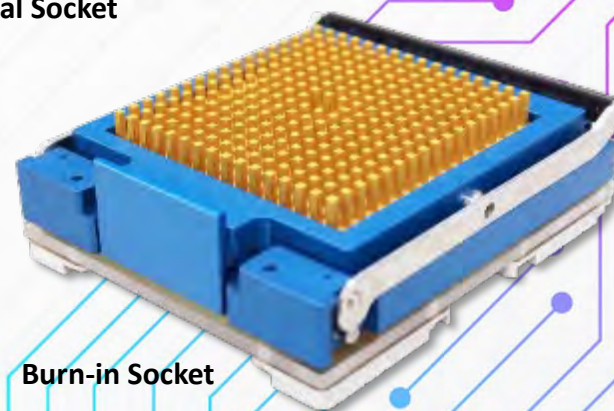


Coaxial Socket

5

2023

**Test and Burn-in
Socket Ranking**



Burn-in Socket

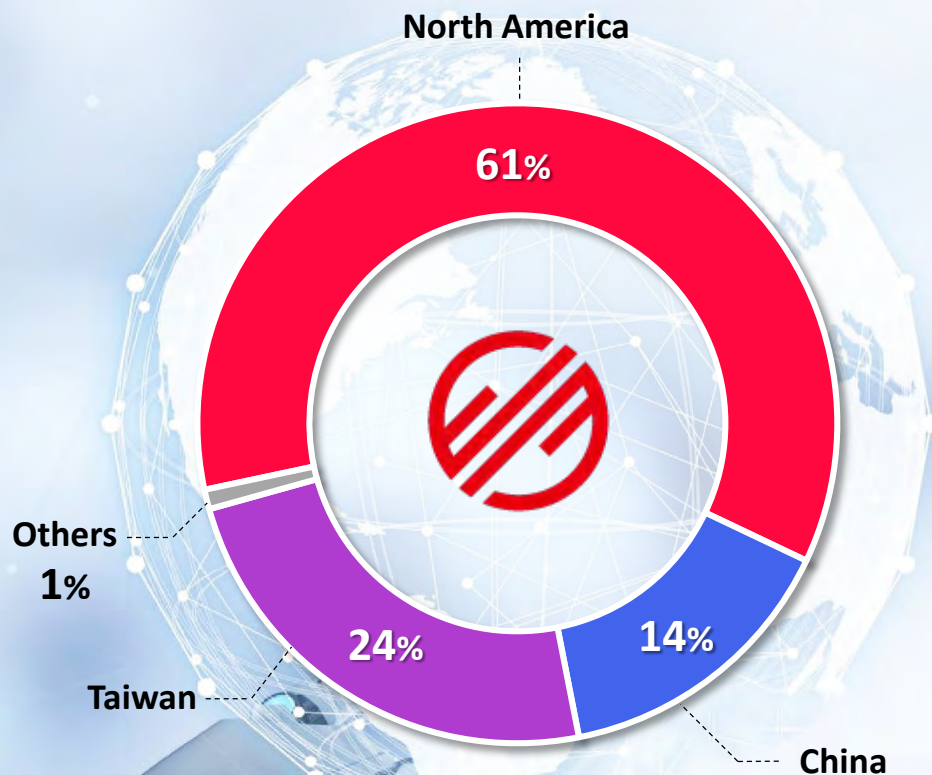
22

2023

**Probe Card
Ranking**

資料來源：Yole Intelligence, 2024/04

全球客戶營收占比



86% Top10 Customers

AI

AP

HPC

CPU

ASIC

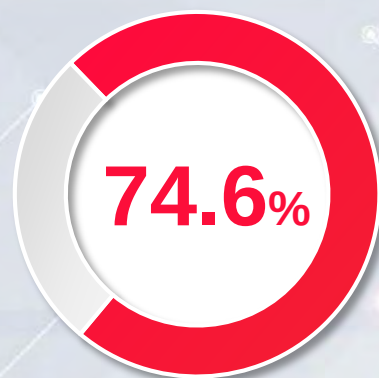
GPU

200⁺ Active Customers

- IC Design ■ IDM
- CSP ■ OSAT
- Foundry

客戶先進製程占比

(First 9 Months of 2024)



Advanced Node



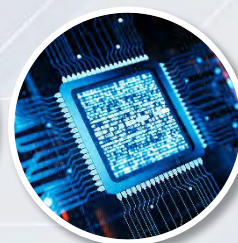
AI



HPC



GPU

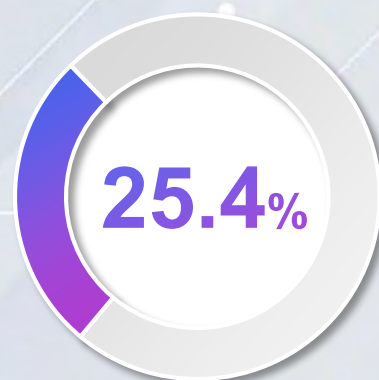


CPU



Smart Phone

7nm (or equivalent node) and below



Mature Node



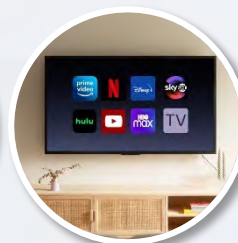
Automotive



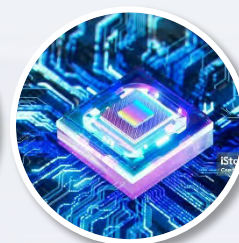
Networking



IoT



DTV & STB



NAND Flash

02

產業趨勢

AI推動半導體市場持續增長

Global AI Economic Impact

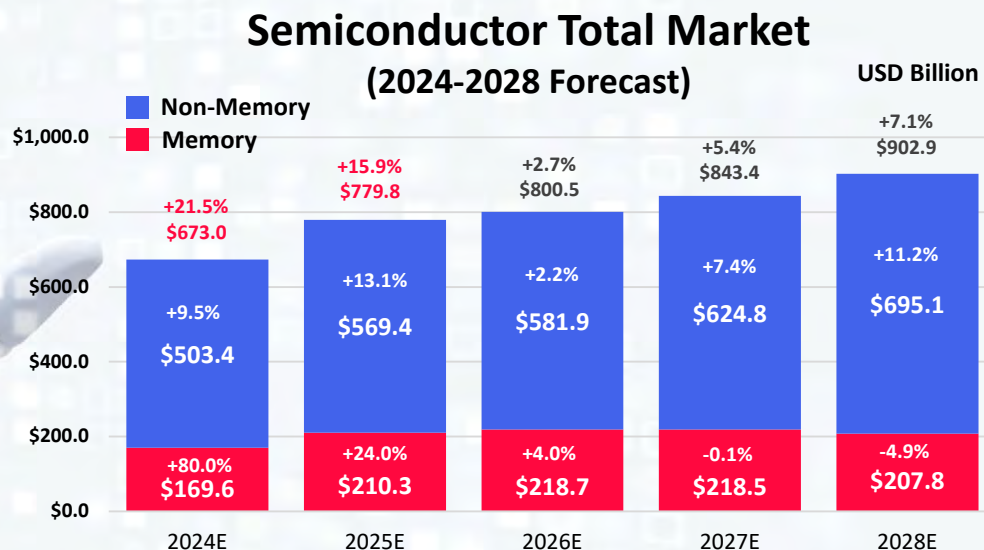
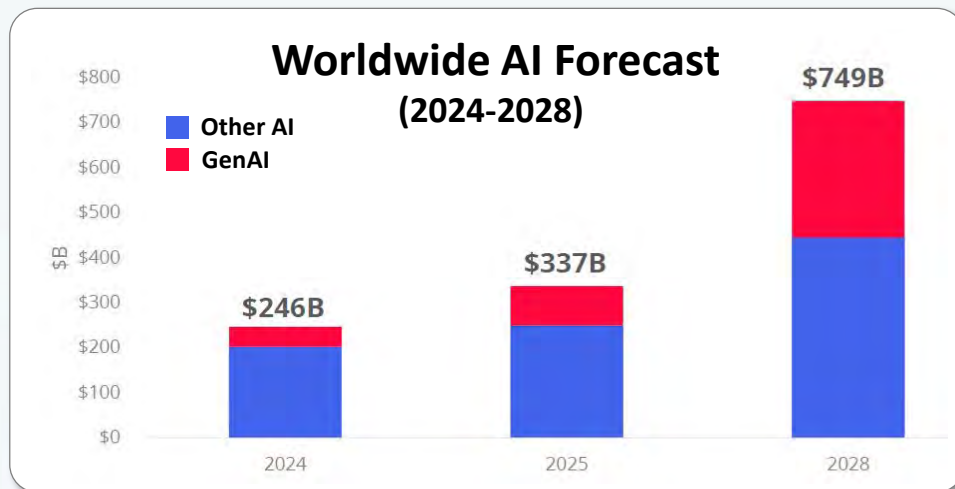
\$19.9

Trillion by 2030

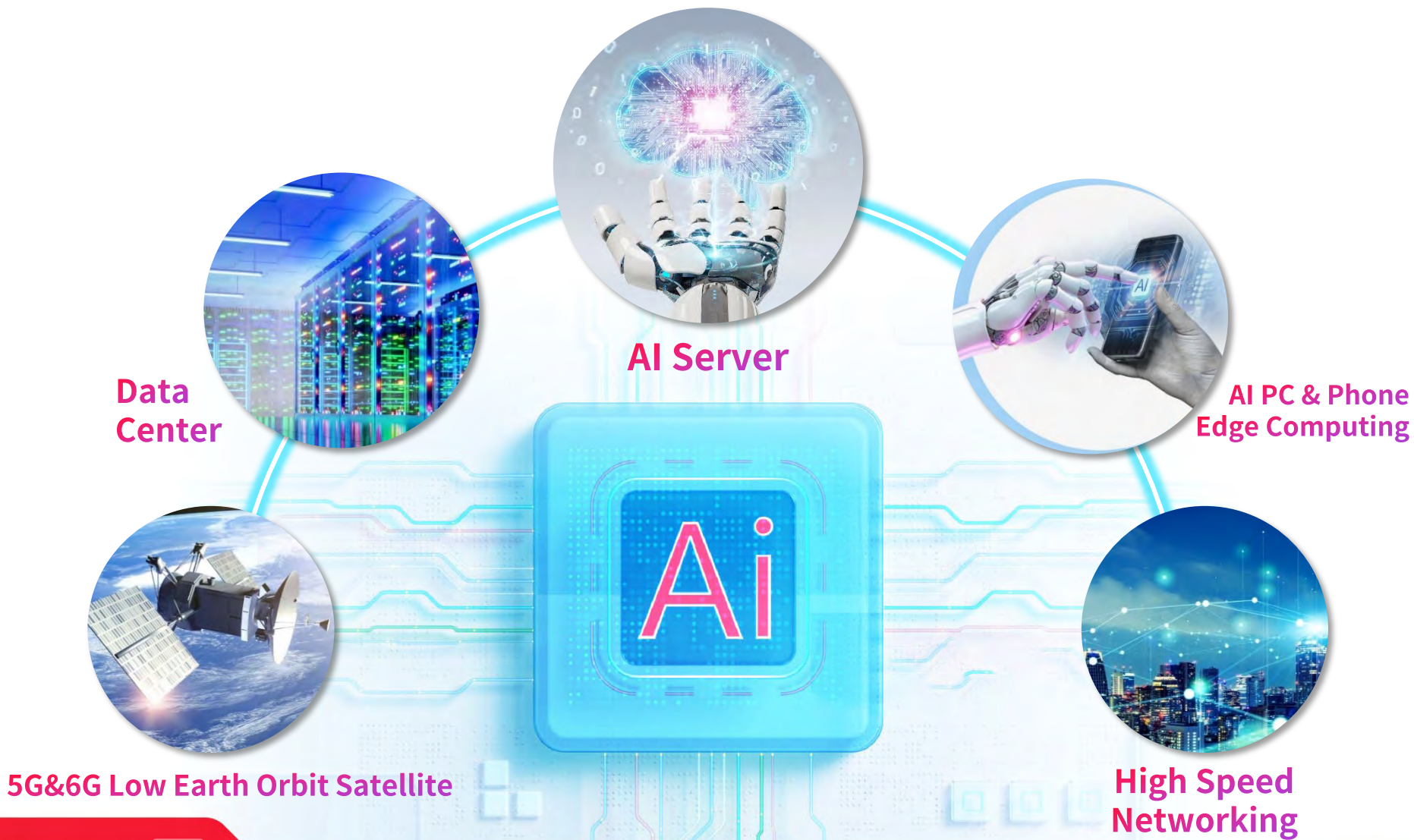
Global GDP

3.5%

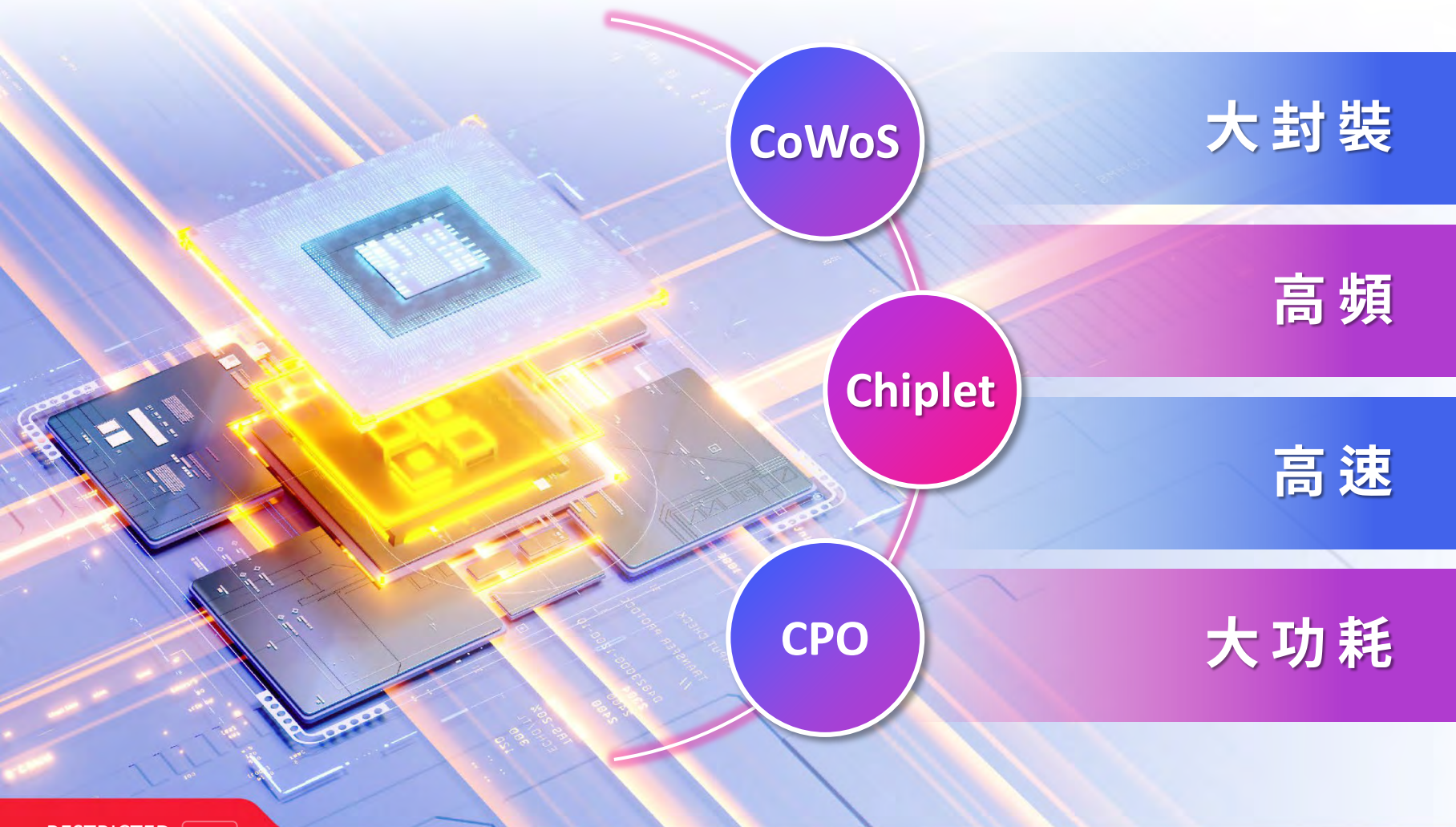
資料來源：IDC, 2024



產業的核心驅動力 — AI

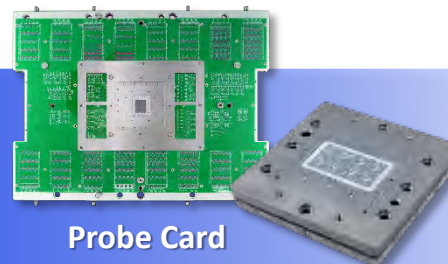


先進封裝引領高階測試需求



半導體測試完整解決方案

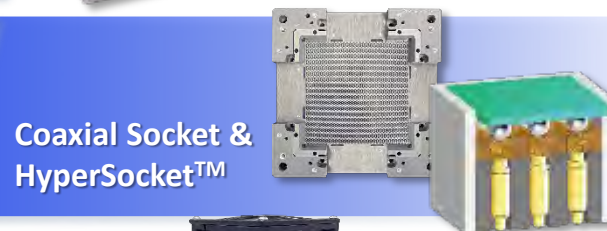
晶圓測試 Wafer Sort
(CP - Circuit Probe)



最終測試 FT
(Final Test)



高頻高速系統測試
SLT (System Level Test) ,SFT



動態老化測試
(Functional Burn-in)



DFT Design For Testing **DFM** Design For Manufacturing

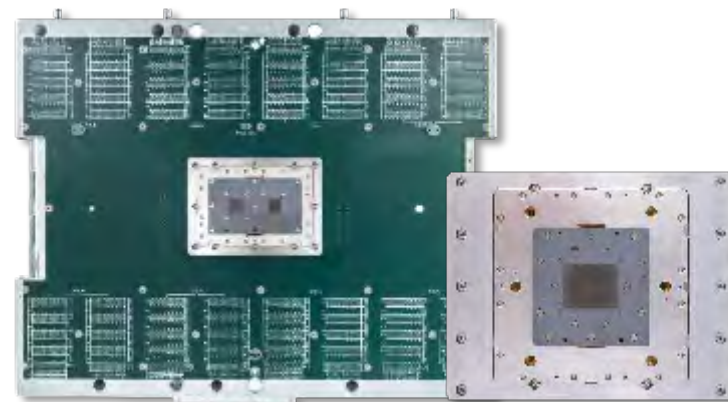
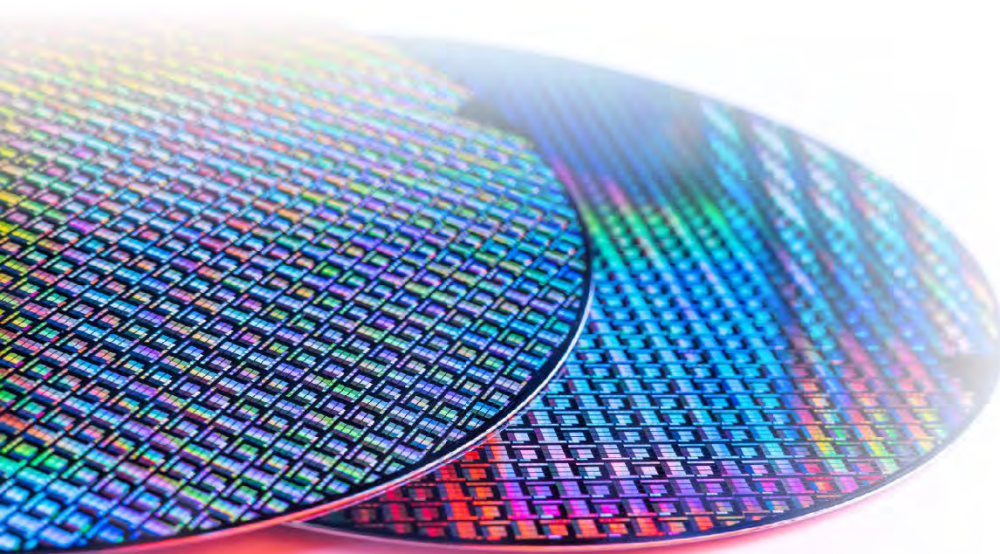
晶圓測試重要性增加

From the Shadows to the Spotlight

K.G.D

Close to
Known Good Die

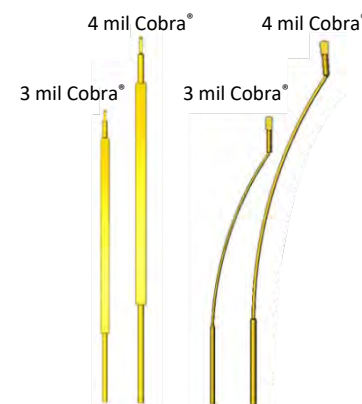
- CoWoS
- Chiplet
- CPO



MEMS VPC



WLCSP Probe Card



Cobra VPC

AI 產品帶動系統測試高速成長

SLT & SFT

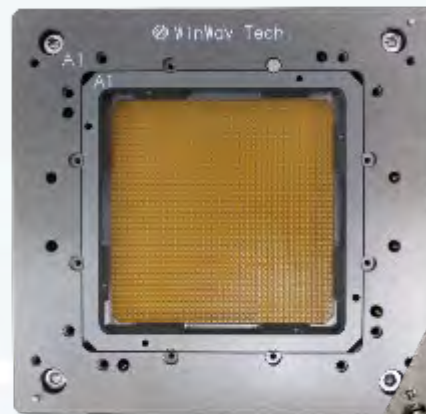
2024-2029 CAGR

More than

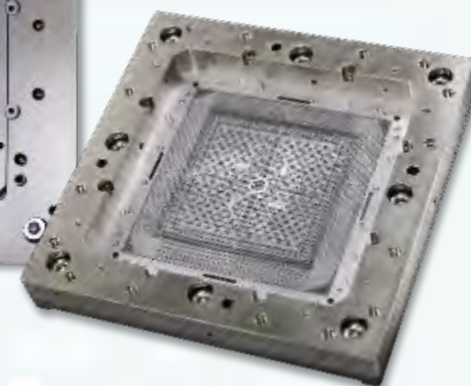
Greater than
industry growth

15%↑

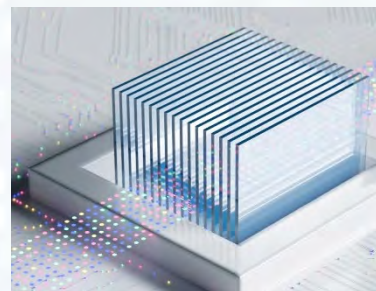
資料來源：WinWay 2024



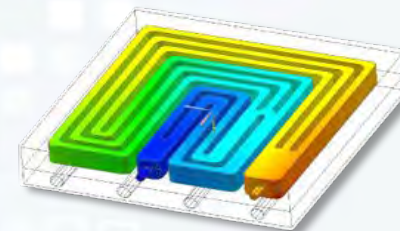
HyperSocket™



Coaxial Socket



Thermal System (Liquid Cooling)



高速老化測試未來趨勢

Functional Burn-in

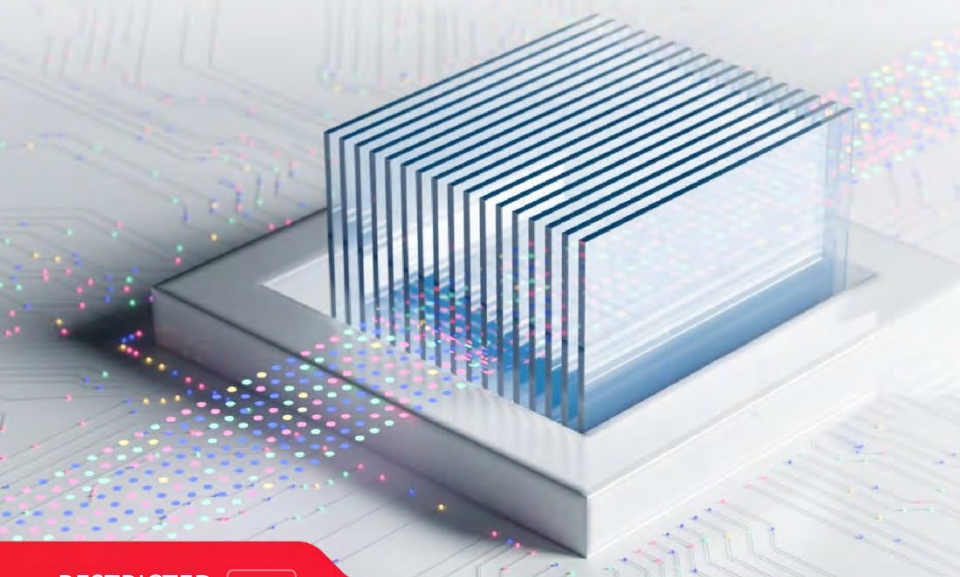
- High Power Burn-In Oven
- System Level Test Burn-In



高瓦數 1000W

大封裝 120 X 120 mm²

高速 PCIE Gen5 32Gbps



**Collaborative
Robot**



Automotive



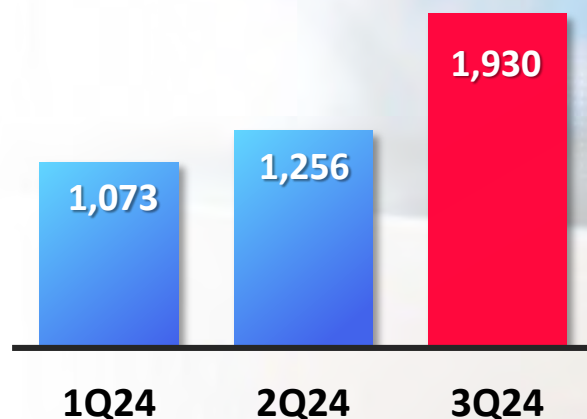
Data Center

03

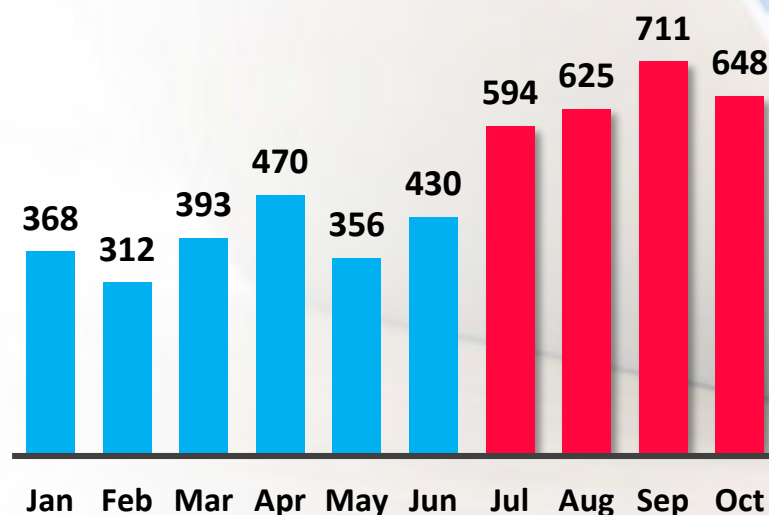
經營績效

營業收入

**QUARTERLY
REVENUE**
(NTD MILLION)



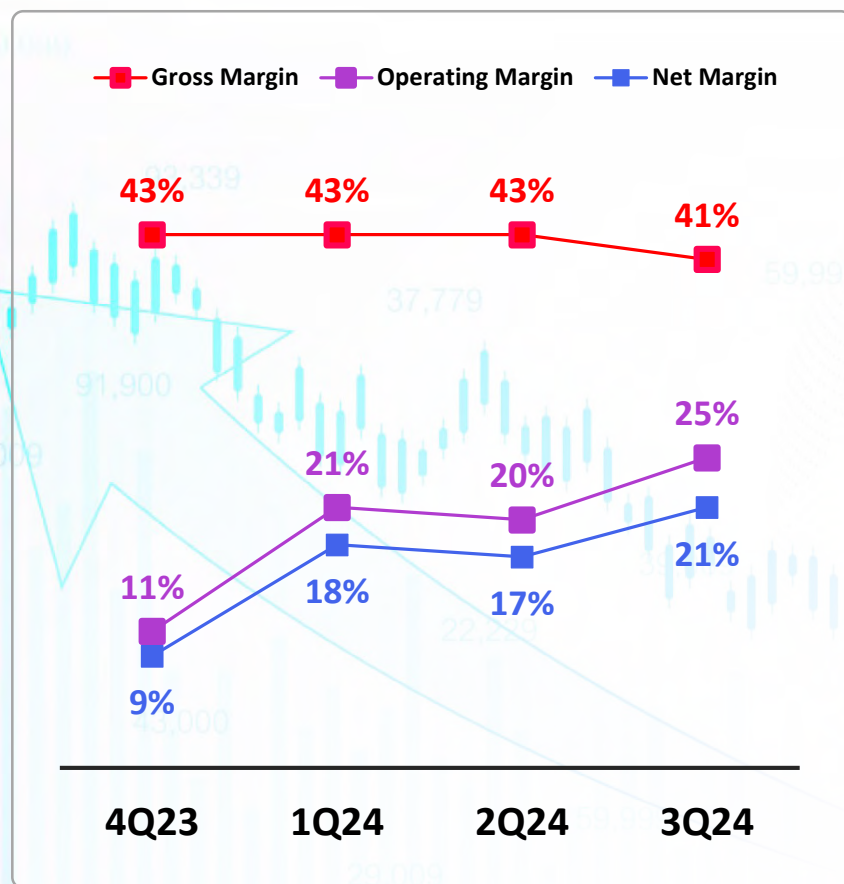
**MONTHLY
REVENUE**
(NTD MILLION)



4.9B

YTD
(First 10 Months of 2024)

獲利績效



First 9 Months of 2024

24.08

EPS (NT\$)

1.68

5.81

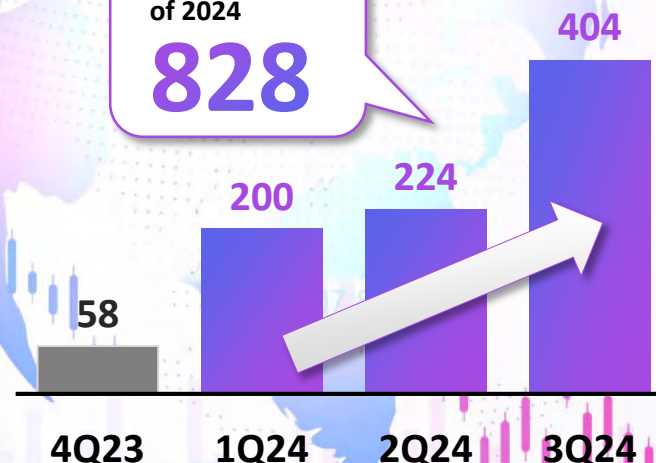
6.52

11.75

NET INCOME (NTD M)

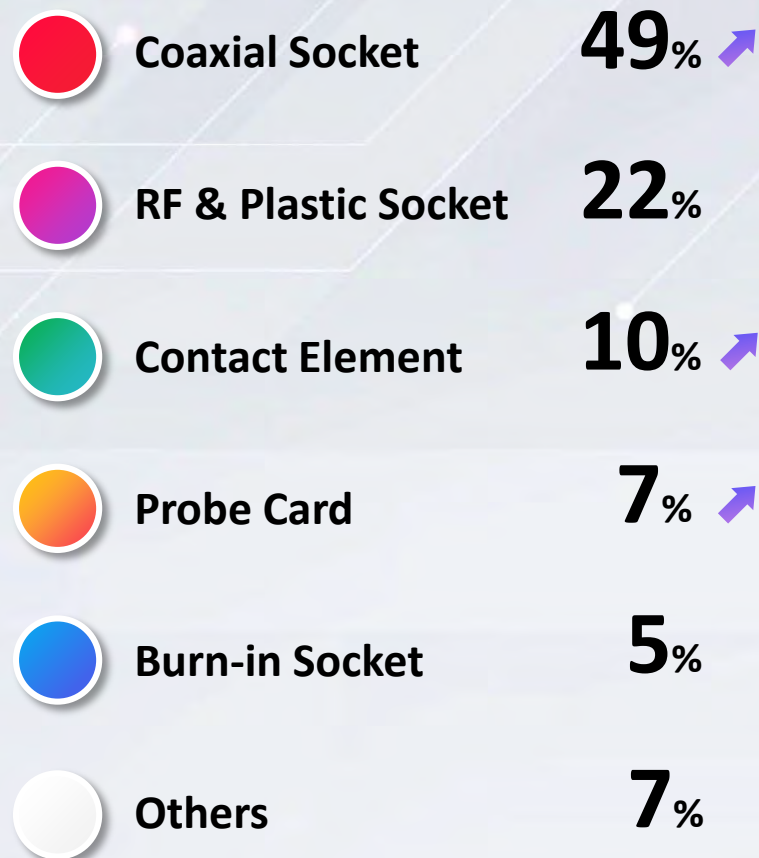
First 9 Months of 2024

828



產品組合

(First 10 Months of 2024)



產品應用

END MARKET (First 10 Months of 2024)

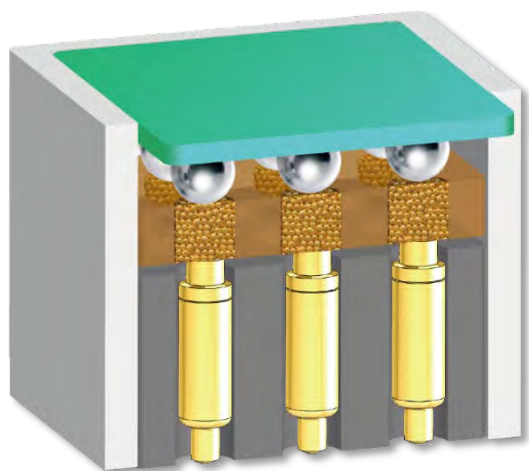


04

創新研發

跨世代全新半導體測試座

WinWay HyperSocket™



- **高速**訊號傳輸最佳方案
- 因應未來**超大封裝**設計趨勢
- 優異**散熱**性能，有效降低探針測試產生的高溫及大電流

Patent NO.

TWI862047

TWI862191

CN20570508U

Patent Pending

USA

Japan

Korea

Malaysia

AI&HPC



SLT

Smartphone



Automotive



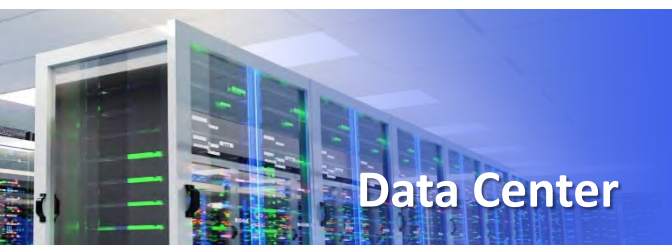
SFT

矽光子CPO共同封裝

提升AI效能的關鍵技術

224Gbps同軸Turnkey方案

自動光電同測整合方案



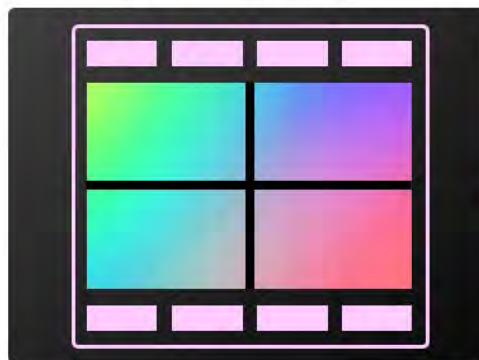
Data Center



High Speed
Networking

Now

With current technologies

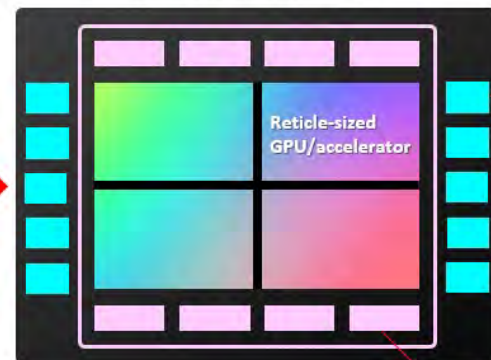


14.4 Tbps off-package

Limited high-bandwidth
domain to within rack (<1.5m)

Tomorrow

Next gen with optical I/O



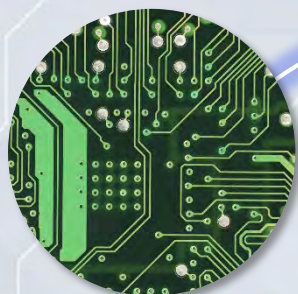
80 Tbps off-package

Rack, multi-rack, cluster (>100m)

資料來源：Ayar Labs

矽光子CPO測試方案

提供全方位CPO測試方案



IC Design



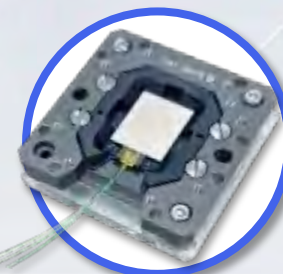
Foundry



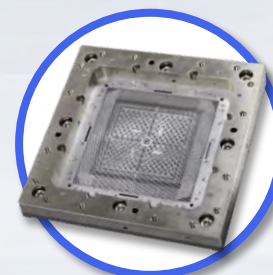
OSAT



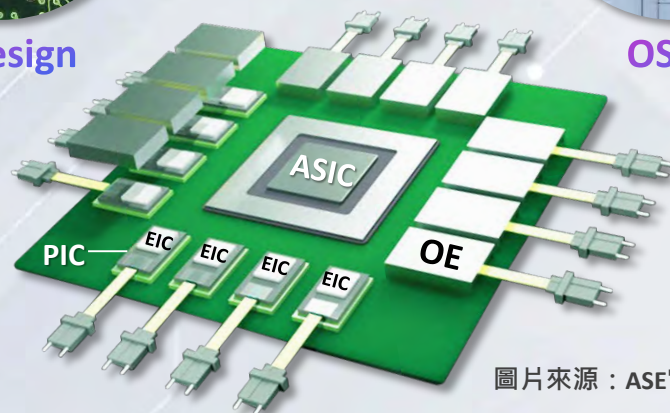
WLCSP Fine Pitch Socket



Optical and Electrical Test Socket



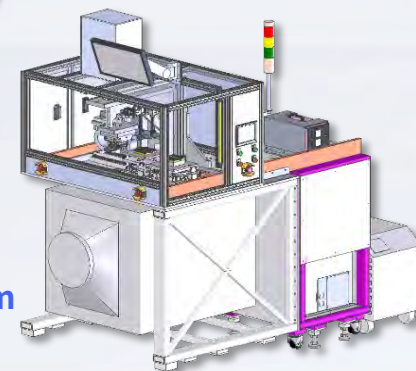
Coaxial Socket



圖片來源：ASE官網

CPO共同封裝光學元件

Double Sided Probing System



5G&6G低軌衛星

WLCSP Probe Card
 High Performance HyperSocket™



Low-Earth Orbit RF Application



UHF頻段
 300MHz - 3GHz
 低速率數據通信



L頻段
 1GHz - 2GHz
 衛星導航系統



S頻段
 2GHz - 4GHz
 地球觀測衛星



C頻段
 4GHz - 8GHz
 廣播衛星



X頻段
 8GHz - 12GHz
 雷達、氣象衛星



Ku頻段
 12-18 GHz
 互聯網服務



Ka頻段
 26.5-40 GHz
 軍事通信衛星

廣頻域

高速率

低延遲

抗干擾

資料來源：ITU, International Telecommunication Union

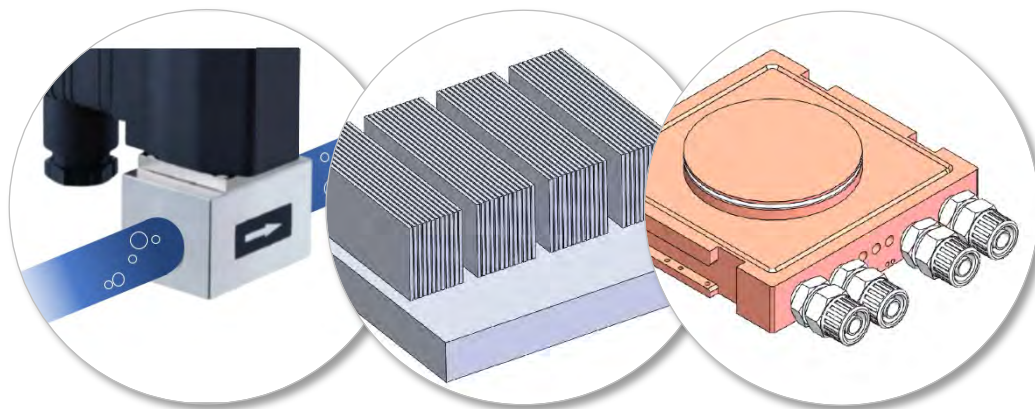
超高功率溫控方案

2000W HEATCon Titan溫控系統

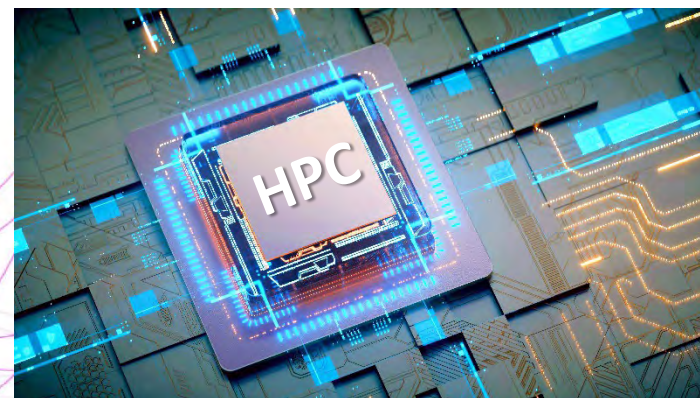
搭配HyperSocket™創造全新Liquid Cooling System

流量控制

流道控制



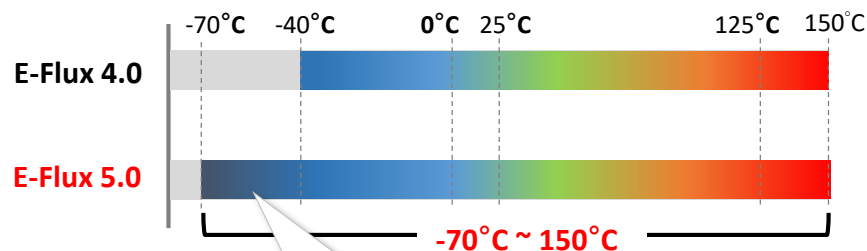
- 搭載多區域溫度檢測機制有效改善發熱不均
- 克服超大封裝變形改善散熱
- 微通道散熱器優化散熱能力



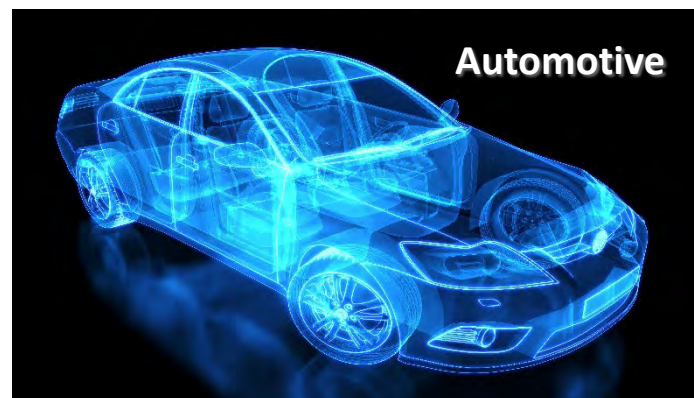
全新開發極低溫溫控方案

E-Flux 5.0 溫控系統

- 創新研發 -70°C 極低溫系統
- 大幅提升負溫環境溫控效能 $-40^{\circ}\text{C}@600\text{W}$



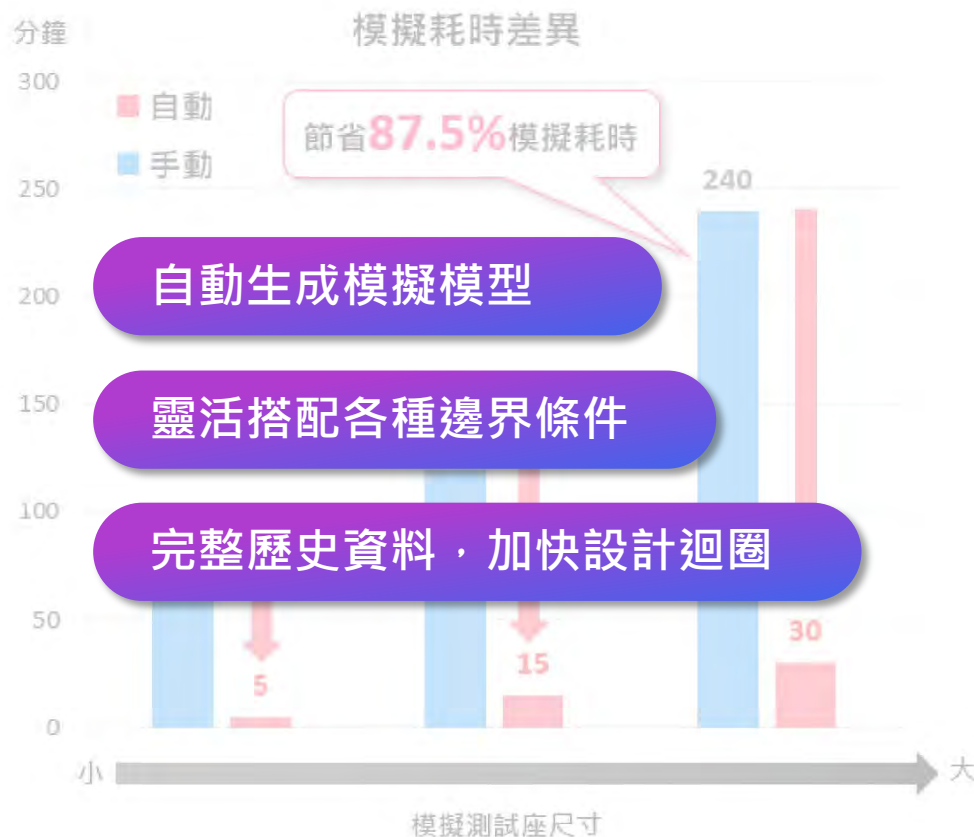
擴大溫域達 30°C



獨家研發高頻模擬自動化

整合程式導入AI資料庫

高頻模擬單月效率大幅提升**300%**



探針自製效益顯現

Socket All in House

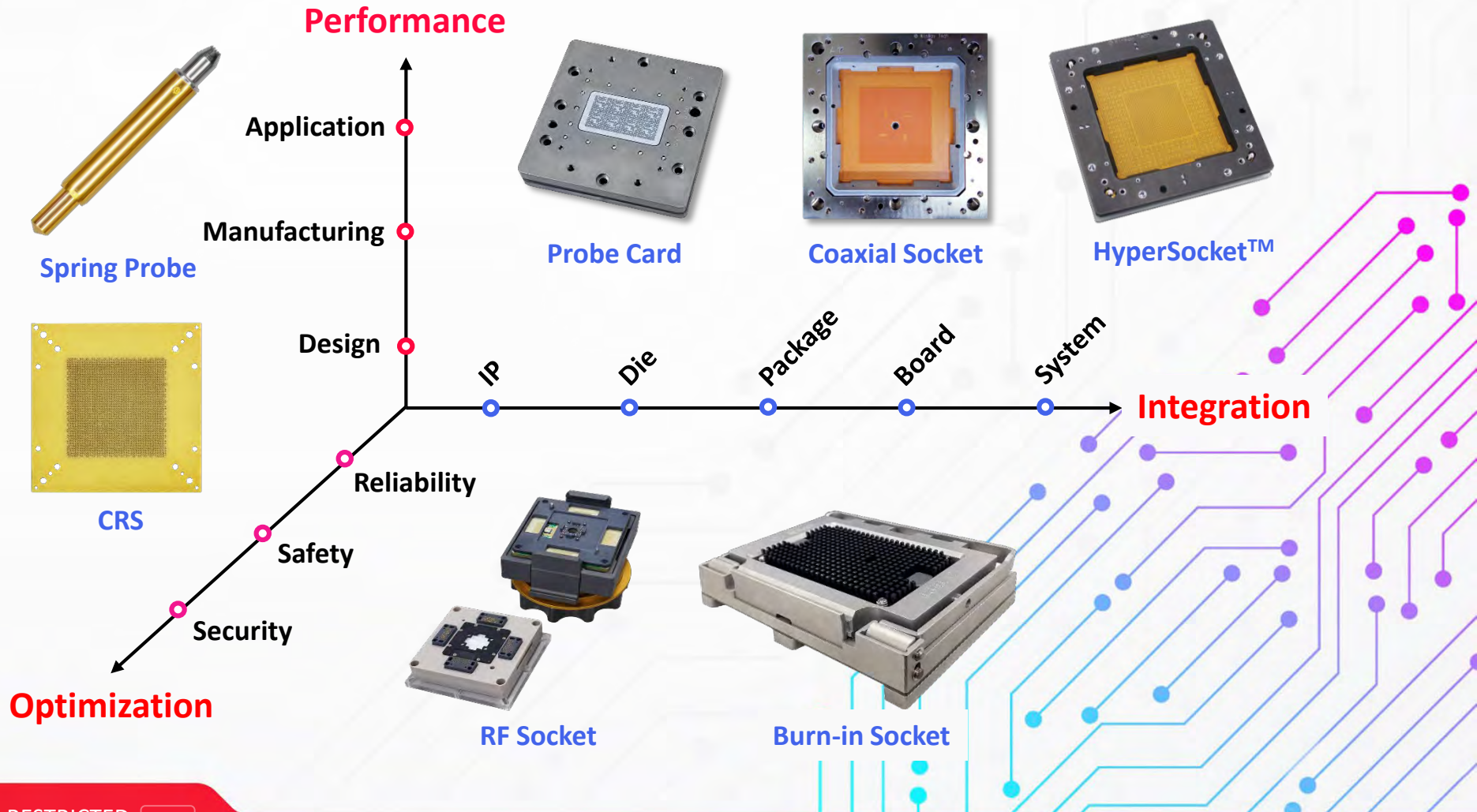
降低成本 客戶拓展

2025需求 **8M** / Month

2025產能 **4.5M** / Month



WinWay , We Test !



2025營收成長動能

HyperSocket™ Coaxial Socket

迎接AI世代來臨

MEMS Probe Card

落實在地服務全球客戶

HP SLT Burn-in

強化市場競爭力

2024 **12.11–12.13** **SEMICON[®]** **JAPAN**

東京ビッグサイト (東京国際展示場)
東展示棟1ホール

Booth 1628

Your Trusted Partner in Semiconductor Testing

SEMICON CHINA

 **2025.03.26-28**

 **China**
Shanghai New International Expo Centre

SEMICON SEA

 **2025.05.20-22**

 **Singapore**
Sands Expo and Convention Centre

SWTEST

 **2025.06.02-04**

 **USA**
Omni La Costa Carlsbad, CA



WinWay

股票代號 6515

Q&A



WinWay

股票代號 **6515**

THANK YOU

You may contact WinWay Technology via

sales@winwayglobal.com

+886 7 361 0999 / +886 3 656 8282

www.winwayglobal.com